

台灣半導體股份有限公司
115 年股東常會議事錄

時 間：中華民國 115 年 6 月 17 日(星期三)上午 9 時整。

地 點：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路 96 號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)

出 席：本公司已發行股份總數(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 2,808,750 後)為 260,676,736 股，親自出席及代理出席股東所代表之股數計 166,868,091 股(其中電子投票股數為 96,695,598 股)，佔已發行股份總數之 64.01%。出席股數已符合公司法及公司章程規定之出席股數。

列 席：王秀亭董事長、鼎翰科技股份有限公司法人代表人王興磊董事、顏國殷董事、詹乾隆獨立董事、陳淑玲獨立董事、王念秋獨立董事等共計 6 人親自出席。

理律法律事務所：田仁杰律師。

安侯建業聯合會計師事務所：郭仰倫會計師。

主 席：王董事長秀亭



記 錄：駱月桂



一、宣佈開會：出席股數已達公司法之規定，依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)。

三、報告事項

(一)本公司 114 年度營業報告及 115 年度營業計劃報告，報請 公鑑。附營業報告書(附件一)。

(二)審計委員會查核 114 年度決算表冊報告，報請 公鑑。
附審計委員會審查報告書(附件二)。

(三)報告本公司及子公司 114 年度背書保證、資金貸與他人、取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形，報請 公鑑。

(四)114 年度董事酬勞金及員工酬勞分派情形報告。

(五)董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告。

(六)買回本公司股份執行情形報告。

四、承認事項

第一案

董事會提

案 由：承認 114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- (一)本公司 114 年度之營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，業經董事會決議通過，並經審計委員會查核竣事。
- (二)本案各項書表請參閱附件一及附件三。提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數： 166,868,091 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數： 156,955,255 權	94.05%
反對權數： 29,384 權	0.01%
無效票權數： 0 權	0.00%
棄權與未投票權數： 9,883,452 權	5.92%

本案經投票表決，照案承認。】

第二案

董事會提

案由：承認 114 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- (一)為健全資本結構，避免盈餘稀釋，擬全數配發現金股利。
- (二)本公司 114 年度稅後純益為 NT\$ 509,576,774 元，加確定福利計劃之再衡量數 1,106,866 元，提列法定盈餘公積 NT\$ 51,068,364 元，加計期初未分配盈餘 NT\$ 1,674,569,359 元，本期可供分配盈餘為 NT\$ 2,134,184,635 元。擬分派股東紅利 NT\$ 526,970,972 元，全部以現金發放，俟股東常會通過後，另訂分配現金股利基準日及發放日；並依分配現金股利基準日股東名簿所載持股，每股配發 NT\$ 2.0 元，現金股利發放至元為止，未滿一元者不計，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
嗣後如因本公司流通在外股數有增減變動，致股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- (三)盈餘分配表請參閱附件四。敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數： 166,868,091 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數： 157,112,019 權	94.15%
反對權數： 32,083 權	0.01%
無效票權數： 0 權	0.00%
棄權與未投票權數： 9,723,989 權	5.82%

本案經投票表決，照案承認。】

五、討論事項：無。

六、臨時動議：無。

七、散 會：上午 9 時 10 分。[本次股東常會無股東提問。](#)

以下為附件：

(附件一及附件三)

附件一：營業報告書

一、114 年度營業報告

1、營業計畫實施成果：

本公司及各子公司主要營業項目為整流器及條碼印表機之製造及買賣業務，114 年度本公司每股稅後盈餘為 2.07 元，茲將本公司 114 年度合併營收淨額、營業毛利、營業淨利、稅前淨利、本期淨利、本期綜合損益及稅後每股盈餘等與 113 年度相較分析列示如下表：

單位：新台幣千元

項 目 名 稱	年 度 經 營 情 況		
	114年度	113年度	增(減)
營業收入淨額	17,954,259	14,828,792	21.08%
營業毛利	5,290,106	4,234,590	24.93%
營業淨利	1,468,136	1,257,215	16.78%
稅前淨利	1,433,139	1,328,359	7.89%
本期淨利	1,112,562	894,913	24.32%
本期綜合損益	1,025,353	1,100,383	(6.82%)
本期淨利歸屬母公司	509,576	463,851	9.86%
綜合損益歸屬母公司	479,727	636,032	(24.58%)
稅後每股盈餘	2.07元	1.87元	10.70%

2、預算執行情形：本公司114年度未公開財務預測，故無需揭露預算執行情形。

3、財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣千元

項 目 名 稱	年 度 收 (支) 情 況		
	114年度	113年度	增(減)
利 息 收 入	45,800	41,582	10.14%
利 息 費 用	133,361	86,579	54.03%

項 目		114年度	113年度
財務結構分析	負債佔資產比率(%)	48.19	49.19
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	374.31	357.73
償債能力分析	流動比率(%)	225.30	204.11
	速動比率(%)	145.39	130.80
獲利能力分析	資產報酬率(%)	5.69	4.98
	權益報酬率(%)	10.15	8.27
	純益率(%)	6.20	6.03
	每股稅後盈餘(元)	2.07	1.87

4、研究發展狀況：

(A)整流器

本公司為提升整體競爭力及毛利率，每年均投入大量人力與預算，蒐集市場資訊，分析市場需求，訂定新產品開發方向與策略。由於現今市場主流產品多朝向輕薄短小發展，為拓展新市場，本公司產品亦積極朝向小型，節能與整體方案化發展，持續專注於汽車電子、工控產業與白色家電市場開發並提升市場滲透率產業。

近年憑藉著自行開發晶片技術以及自動化封裝優勢，持續在蕭特基整流器、快速恢復晶圓(FRED)、突波抑制器(TVS)、MOSFET、ESD 保護元件，車用低壓差/低耗電穩壓IC等產品進行研發。

晶片技術研發新一代的溝槽式蕭特基整流器(Trench schottky rectifier)、快速恢復晶圓(FRED)、超接面金氧半場效電晶體 (Super Junction MOSFET)，以及屏蔽柵技術SGT (Shielded Gate Technology) MOSFET有效降低導通損耗與開關損失，滿足環保以及節能低功耗的市場趨勢與需求。這些新技術將全系列開發以利推廣用於汽車電子主/被動安全應用、電動汽車電池管理系統與充電模組、工業、通訊、能源產業。

自113年起，本公司在突波抑制器(TVS)產品線上，陸續研發成功並率先導入 SuperClamp 系列產品，其超低箝制電壓的表現領先同業，將可協助客戶進一步提升系統效能，同時達到節能與降低系統成本的目的。

同時針對新興第三代半導體的技術，本公司亦積極投入資源進行相關技術與產品的研發，碳化矽蕭特基整流器(SiC Schottky Diode) 已陸續上市新產品，碳化矽金氧半場效電晶體(SiC MOSFET) 的研發也在進行中。

ESD保護元件的開發持續專注於符合各式車內通訊標準與乙太網路需要的靜電保護產品。

此外，各類低功耗高輸出電流的車用低壓差/低耗電穩壓器IC也陸續開發中，可涵蓋於供應給車用MCU 3.3V及5V的穩壓源，目前已有部分 自主

研發完成，且已投入更多人力及設備成本在車用法規的驗證，目前正陸續通過AEC-Q100車用法規的驗證，希望能以高品質與服務獲得車用客戶的認可。

(B)條碼印表機

隨著全球市場對自動識別的應用增加，本公司 114 年度研發支出共投入 604,239 仟元，占全年度營業收入達 5.2%，並將持續推動企業行動電腦、標籤印表機、RFID 讀取器創新與產品升級。透過全方位的技术提升，積極投入 AI、IOT 與自動化辨識產業相關硬體與系統技術之研發，另投入發展雲端解決方案及軟硬體解決方案與系統整合，與合作夥伴共同整合雲端平台生態系，並致力於滿足企業在 AIDC 行業應用中的各種需求，也確保產品具備良好的擴充性與選配彈性，以適應未來發展。同時，公司也將延續環境永續價值觀，持續投資在環保材料、低碳列印方案、低能耗產品、打造節能、可回收、低碳排放的產品。以 ESG 作為其中一項核心競爭力，吸引更多國際型終端客戶的採購。

二、115 年度營業計劃

本公司秉持穩健經營與永續發展之核心理念，持續深化技術研發、優化產品組合、拓展國際市場版圖，並強化供應鏈韌性與營運效率。面對全球總體環境變動與產業結構調整，本公司以「技術領先、品質為本、客戶導向、全球布局」為原則，推動功率半導體與電源管理相關產品之升級與滲透，並聚焦汽車、工控及電源管理等高價值領域，以提升競爭力與長期股東價值。

1、經營方針：

(A)整流器

(1)全球行銷與品牌建構

持續優化全球行銷通路與在地技術服務據點，強化與策略客戶之協同開發與應用導入；同時擴大於汽車、工控與電源管理等關鍵市場之品牌能見度，聚焦高可靠、長壽命與高效率設計要求，建構差異化價值主張。

(2)研發創新與技術領先

持續擴充並強化研發團隊，加速新一代產品及整合方案之研發，確保在整流器、金氧場效電晶體(MOSFET)、蕭特基等核心技術上保持領先地位。

(3)生產升級與成本優化

持續導入先進生產設備、自動化系統與智慧製造技術，提升產能利用率與製程良率，強化生產效率與品質穩定度。透過數據化管理與製程即時監控，優化生產流程並降低異常風險，提升整體營運效能。

同時，積極推動先進封裝技術（包含極薄貼片與高電流密度方案）與製程優化，降低單位製造成本並提升產品性能與可靠度。在產品開發端導入模組化設計與共用平台管理機制，縮短設計至量產之轉換週期，提高

交付彈性與市場反應速度，進一步強化成本競爭力與獲利能力。

(4)垂直整合與戰略聯盟

建構從晶圓上游至系統應用的完整供應鏈，並與國際一流大廠及跨國設計服務夥伴展開密切合作，提升供應穩定性與地緣政治風險下之營運韌性，共同研發革命性產品，以整合方案滿足市場多元需求。

(B)條碼印表機

集團將以「One Brand」與全球行銷平台為核心，整合產品線與區域市場資源，打造一體化行銷生態系；並導入資料驅動行銷，提高推廣精準度，加速跨產品線與跨市場的協同效益。此外，公司將持續強化全球經銷生態鏈，透過標準化合作制度、長期賦能與解決方案工具，提升市場深耕能力。面對 IoT、AI、智慧物流等趨勢，鼎翰將擴大在關鍵應用場景中的策略角色，推動技術採用與品牌影響力提升。透過全球化品牌建設、一體化行銷生態系與強韌通路網絡，鼎翰將持續擴大市佔率，強化企業價值的長期成長動能，穩健邁向國際領導品牌目標。因應全球企業對ESG永續發展的重視，持續投資在環保材料、低碳列印方案、低能耗產品、打造節能、可回收、低碳排放的產品。

2、重要產銷政策：

(A)整流器

採取計劃性與接單式生產並行模式，依據市場需求、庫存狀態與產能規劃，靈活調整生產計劃。持續導入流程優化，透過精實管理與自動化生產降低成本、提升產能及產品競爭力，確保最佳庫存水準與供貨彈性，提供資源最佳配置與營運效率最大化。

(B)條碼印表機

本公司主要營收來源為自動識別標籤印表機整機銷售與服務、標籤紙耗材銷售及企業行動電腦等，銷售數量係依據本公司年度銷售目標、市場需求狀況與發展趨勢、客戶營運概況及本公司目前接單情形等因素，並參酌本公司營運規模合理編製而成，預估本公司業績將呈穩定發展趨勢，對財務業務狀況帶來正面助益。

在此預計基礎下，未來產銷政策方面的進行重點如下：

- (1) 確保重要供應商的供貨來源及品質穩定，並維持適當之庫存金額與週轉率。
- (2) 持續擴大全球營運規模及強化公司營運基本面之核心競爭力。
- (3) 提供全方位優質服務，建立永續經營實力。

3、營業目標：

(A)整流器

本公司主要產品涵蓋整流二極體、功率MOSFET、保護元件及類比/電源管理IC。基於年度銷售目標、整體市場需求與接單狀況之綜合評估，預期業績維持穩健成長軌跡。成長動能將來自車用與工控導入擴大、通訊與

資料中心電源之效率升級等應用之滲透提升，並持續優化營收結構與獲利表現。

(B)條碼印表機

本公司主要營收來源為自動識別標籤印表機整機銷售與服務、標籤紙耗材銷售及企業行動電腦等，銷售數量係依據本公司年度銷售目標、市場需求狀況與發展趨勢、客戶營運概況及本公司目前接單情形等因素，並參酌本公司營運規模合理編製而成，預估本公司業績將呈穩定發展趨勢，對財務業務狀況帶來正面助益。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1、未來公司發展策略

(A)整流器：

持續推動技術創新與研發升級，提升產品價值與技術壁壘，完善上下游佈局以強化整合效益。建構完整產品解決方案，並透過先進製程與結構優化，提高效率、耐壓與功率密度，增強產品附加價值。市場布局方面，深化車用、工控與電源管理領域，積極滲透新興應用市場，加速設計導入，提升市場進入門檻與客戶黏著度。

(B)條碼印表機：

持續秉持以客戶為中心的原則，持續品牌，產品，行銷與客服的整合，提供客戶一體化的服務與體驗，以強化市場形象並提升競爭優勢。洞悉全球各地不同產業客戶的各種運用變化，並與上下游伙伴更緊密合作，以新的商業思維模式尋找新客戶、新解決方案、創新服務模式以及開發新產品，創造多贏成長契機。

2、受到外部競爭環境之影響。

(A)整流器

在中低階市場價格競爭持續加劇之挑戰下，本公司始終堅守以高規格設計、高可靠度品質與系統效能優化為核心差異化策略，持續提升產品技術含量與應用價值，並優化整體產品組合與獲利結構，以確保營運品質與長期競爭優勢。

公司聚焦車用、工業控制及電源管理等高技術門檻與高品質要求之應用市場，持續推出高效率、低損耗及高溫等級產品，強化整體解決方案與設計導入能力，提升專案成功率與訂單能見度。透過產品結構優化與技術持續升級，穩健鞏固品牌定位與市場競爭優勢，同時兼顧節能減碳與永續經營目標，為創造長期且穩定之企業價值。

(B)條碼印表機

主要競爭與發展趨勢如下：

1. 垂直整合與跨產品套件競爭加劇

大型品牌透過併購或平台化策略持續擴張產品與服務邊界。例如 Zebra 由硬體供應商逐步升級為整體解決方案提供者，透過收購強化自助設備、觸控系統、軟體、雲端管理與支付能力，強化其在零售與物流領域

的上游整合。

2. RFID 與物聯網化需求快速擴大

RFID 普及率提升後，市場出現高密度、多天線、固定式書架/門框/車載型等新型讀取器需求。競爭焦點逐漸從「硬體性能」轉向「硬體 + 中介軟體 + IoT 平台」的整合能力，使廠商需具備更完整的資料串接與設備管理能力。

3. 軟體與服務平台成為關鍵差異化因素

各產品線競爭不再只比硬體規格，而是比誰能提供更完整的解決方案：

- 遠端設備管理 (MDM / FMS)
- 車隊/資產管理
- 預測性維護
- 耗材與標籤管理
- 雲端應用整合能力

這些軟體與服務逐漸成為企業選擇品牌的重要因素。

4. 永續趨勢與成本壓力驅動創新

Linerless 無底紙標籤、減碳及耗材優化成為標籤印表機的重要驅動力。同時，全球供應鏈成本、原物料價格與運輸費用變動，使廠商面臨定價與利潤壓力，也促使品牌投入更高效率、更低 TCO (Total Cost of Ownership) 的產品設計。

總結來說，市場競爭正從「硬體對硬體」轉為「整體解決方案、生態系統與數位服務」的全面競爭。廠商需透過技術創新、軟硬整合與產業生態鏈合作，才能滿足各產業加速數位化的營運需求。

3、法規環境之影響

(A) 整流器

隨著全球對環保節能與產品安全標準要求日益嚴格，半導體產業面臨更高之法規遵循與品質管理門檻。市場對功率元件於材料環保性、低能耗、高效率及小型化設計之要求持續提升。本公司於產品設計、製程控管與研發方向上，均積極回應國際法規與產業標準之變化，確保產品除符合各國規範外，亦能兼具技術領先性與高可靠度。

1. 無鹵環保設計-滿足歐盟RoHS規範要求

全系列產品均採用無鹵材料，符合歐盟RoHS等環保規範。透過環保材料選用及供應鏈管理，降低有害物質使用，同時確保產品可靠性與性能穩定。

2. 提升能效—因應EISA等節能標準

於整流器與功率元件設計上著重降低電性損耗與封裝優化，提升轉換效率與功率密度。針對家電及電源應用市場，開發具高耐壓、快速恢復與低損耗特性之蕭特基元件，以符合待機能耗與能源效率規範。

3. 提升能效—因應EISA等節能標準

提供低耗損、高結溫的蕭特基產品，適用於太陽能模組與電源轉換器。助力客戶在追求環保節能的同時，實現高效能能量轉換。

4. 電動車技術革新支援

因應電動車充電架構由AC轉DC高壓化，以及電力系統由12V／24V向48V架構升級之趨勢，推出高壓快速恢復二極體、低損耗整流器與溝槽式蕭特基產品，並依循車用品質管理體系與相關認證標準開發設計，提升產品於電動車動力與充電系統之適用性與競爭力。

(B)條碼印表機

最近年度國內外重要政策與法律之變動對公司營運並無重大影響，對於法規環境的變化亦均予以遵循。

4、總體經營環境之影響

(A)整流器

在全球經濟整合深化與電子產業快速轉型之趨勢下，本公司憑藉完善之全球通路網絡與技術服務據點，持續推出創新技術與整體解決方案，提供高效率、高可靠度且具前瞻性的產品與服務。此一全球化布局有效串聯各地客戶與供應鏈資源，使公司得以因應市場波動與產業變革，在競爭激烈之環境中維持穩健成長並持續提升品牌價值。

在全球供應鏈再平衡與地緣政治風險升高之背景下，本公司透過全球銷售與技術服務節點之布局，結合多地生產與多元採購策略，強化供應鏈韌性與風險分散能力。同時，持續推出高效率與高可靠之功率與保護元件，支援客戶於汽車、工業控制、通訊及再生能源等領域之升級與轉型需求，提升長期合作深度與市場競爭優勢。

面對整體經營環境之多重影響，公司採行區域化深耕與多元化布局策略，推動市場擴張與產業發展：

• 北美市場：

聚焦汽車、工業、電信及照明等成熟應用領域，優化產品結構並提升高附加價值產品占比，以強化獲利品質。

• 日本及韓國市場：

深耕車用、工業與電源管理應用市場，透過精細化技術服務與高品質產品，提升客戶黏著度與品牌信賴度。

• 歐洲市場：

以汽車電子、工業自動化及再生能源為核心，回應歐洲對綠色節能與高效能技術之需求，強化高規格產品滲透率。

• 中國大陸及新興市場：

涵蓋消費性電子、汽車及工業應用，同時拓展印度、南亞與南美等新興市場。隨內需市場成長與基礎建設推動，帶動功率元件需求提升，為公司創造中長期成長動能。

綜合而言，本公司透過全球布局優化、供應鏈強化與高價值產品策略，穩健因應總體經營環境之變動，持續提升營運彈性與市場競爭力，為企業永續發展奠定堅實基礎。

(B)條碼印表機

對於法規環境的變化亦均予以遵循。

展望未來，本公司及各子公司隨著整流器及條碼印表機市場的穩定成長及應用範圍日益擴展，加上垂直布局趨於完整，本公司將秉持創新、專業與敬業的經營理念，並持續強化團隊的研發及銷售能力，提昇業績與獲利，讓股東、客戶及員工共享豐碩的營運成果。

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠



附件三：財務報表



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No.7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

台灣半導體股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

台灣半導體股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達台灣半導體股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台灣半導體股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

其他事項

列入台灣半導體股份有限公司採用權益法之投資中，於民國一一四年十二月三十一日有關鼎翰科技股份有限公司（鼎翰科技）之部分轉投資子公司財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關鼎翰科技該等轉投資子公司財務報告所認列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一四年十二月三十一日對鼎翰科技該等轉投資採用權益法之投資金額占資產總額之5.78%，民國一一四年一月一日至十二月三十一日對其採用權益法認列之子公司利益份額占稅前淨利之4.06%。

列入台灣半導體股份有限公司採用權益法之投資中，於民國一一三年十二月三十一日有關鼎翰科技之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關鼎翰科技財務報告所認列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一三年十二月三十一日對鼎翰科技採用權益法之投資金額分別占資產總額之10.49%，民國一一

三年一月一日至十二月三十一日對其採用權益法認列之子公司利益份額分別占稅前淨利之39.31%。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台灣半導體股份有限公司民國一一四年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)收入之認列；收入之說明請詳個體財務報告附註六(十六)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

台灣半導體股份有限公司主要營業項目為整流器之製造及買賣業務，收入認列為本會計師執行該公司財務報告查核重要評估事項。銷貨收入係投資人及管理階層評估公司績效之主要指標，故收入認列之合理性為本會計師執行查核重要評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序，包括測試銷貨及收款作業循環之相關控制，以確定收入紀錄可靠性；針對銷售系統資料與總帳分錄進行核對及調節，及評估銷售條件與會計政策認列之一致性；針對前十大銷售客戶進行趨勢分析，以評估是否有重大異常；選定資產負債表日前後一段期間之出貨，核對相關憑證及表單以確定銷貨收入是否認列於財務報表適當期間。

二、採用權益法之投資減損評估

有關採用權益法之投資之會計政策請詳個體財務報告附註四(八)投資子公司及(十二)非金融資產減損；採用權益法之投資之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(三)採用權益法之投資減損評估；採用權益法之投資之說明，請詳個體財務報告附註六(五)採用權益法之投資。

關鍵查核事項之說明：

台灣半導體股份有限公司採用權益法之投資中，鼎翰科技股份有限公司(鼎翰科技)於企業合併取得業務及控制權時，於合併財務報告認列商譽，該等金額對財務報告係屬重大，此外，衡量商譽是否減損，有賴對現金產生單位未來現金流量之估計以決定可回收金額，未來現金流量之估計涉及產業狀況及未來營運成果等之預估，該等預估情況一旦改變，將影響可回收金額而產生減損。因該等採用權益法之投資係台灣半導體股份有限公司之重要轉投資且該帳面金額對個體財務報告係屬重大，因此，本會計師認為台灣半導體股份有限公司對該等採用權益法之投資所作之減損評估，為本年度執行查核重要評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括取得鼎翰科技管理階層委任之評價專家所出具之商譽價值減損測試評估報告及管理階層自行評估之商譽減損測試評估，瞭解並評估其評價模型所計算可回收金額之合理性；並對評價模型所使用之假設包括銷售成長率、

利潤率、加權平均資金成本（包括無風險報酬利率及風險貼水報酬）等，考量公司過去營運狀況、所屬產業情況及未來展望等，綜合評估上述商譽減損評估之合理性。

本會計師亦比較採用權益法之投資帳面金額及鼎翰科技財務報告中所揭露之其淨資產餘額差異（依台灣半導體股份有限公司持有之所有權份額）並觀察鼎翰科技於證券市場之價格。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估台灣半導體股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台灣半導體股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣半導體股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台灣半導體股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台灣半導體股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台灣半導體股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示

意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成台灣半導體股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台灣半導體股份有限公司民國一一四年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

郭仰倫



蕭佩如



證券主管機關：金管證審字第1120333238號
核准簽證文號：金管證審字第1040003949號
民國一一五年三月十三日

台灣半導體股份有限公司

資產負債表

民國一一四年及一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產		114.12.31		113.12.31		負債及權益		114.12.31		113.12.31	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 669,109	6	562,610	5	2100	短期借款(附註六(九))	\$ 408,590	4	445,065	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	60,068	1	20,089	-	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	175	-	859	-
1150	應收票據淨額(附註六(三))	-	-	12	-	2170	應付帳款	283,150	3	250,992	2
1170	應收帳款淨額(附註六(三))	564,049	5	490,650	5	2181	應付帳款－關係人(附註七)	713,957	7	323,092	3
1180	應收帳款－關係人淨額(附註七)	524,507	5	526,973	5	2220	其他應付款－關係人(附註七)	20,300	-	43,971	-
1200	其他應收款(附註七)	53,463	-	31,252	-	2230	本期所得稅負債	2,879	-	113,137	1
1220	本期所得稅資產	-	-	89,684	1	2320	一年內到期長期借款(附註六(十))	120,052	1	106,683	1
130X	存貨(附註六(四))	909,308	9	1,083,837	10	2280	租賃負債－流動(附註六(十一))	404	-	957	-
1479	其他流動資產	82,370	1	74,286	1	2399	其他流動負債	302,380	3	330,636	3
		2,862,874	27	2,879,393	27			1,851,887	18	1,615,392	15
非流動資產：						非流動負債：					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	125,237	1	66,152	-	2541	長期借款(附註六(十))	702,364	6	644,675	6
1551	採用權益法之投資(附註六(五))	5,550,786	52	5,192,648	50	2570	遞延所得稅負債(附註六(十三))	433,280	4	425,721	4
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六))	1,893,461	18	2,086,694	20	2580	租賃負債－非流動(附註六(十一))	-	-	403	-
1755	使用權資產(附註六(七))	694	-	2,359	-	2640	淨確定福利負債(附註六(十二))	3,304	-	5,602	-
1822	無形資產(附註六(八))	41,744	-	55,786	1			1,138,948	10	1,076,401	10
1840	遞延所得稅資產(附註六(十三))	67,601	1	60,299	1		負債總計	2,990,835	28	2,691,793	25
1980	其他金融資產－非流動(附註六(二))	1,435	-	18,143	-						
1990	其他非流動資產	89,842	1	124,673	1		權益總計				
		7,770,800	73	7,606,754	73		負債及權益總計	\$ 10,633,674	100	10,486,147	100
資產總計		\$ 10,633,674	100	10,486,147	100						

台灣半導體股份有限公司

綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
4110	銷貨收入(附註六(十六)及七)	\$ 4,714,632	104	4,295,553	102
4190	減：銷貨退回及折讓	165,069	4	98,547	2
	營業收入淨額	4,549,563	100	4,197,006	100
5000	營業成本(附註六(四)及七)	3,962,077	87	3,489,795	83
	營業毛利	587,486	13	707,211	17
5910	已(未)實現銷貨利益	23,008	1	(354)	-
		610,494	14	706,857	17
6000	營業費用(附註六(十二)、(十八)及七)：				
6100	推銷費用	392,517	9	351,858	8
6200	管理費用	180,939	4	198,054	5
6300	研究發展費用	141,019	3	126,066	3
6450	預期信用減損損失(附註六(三))	771	-	151	-
		715,246	16	676,129	16
	營業淨利(損)	(104,752)	(2)	30,728	1
	營業外收益及費損(附註六(十七)及七)：				
7100	利息收入	5,154	-	5,476	-
7010	其他收入	8,502	-	15,649	-
7020	其他利益及損失	40,484	1	84,863	2
7050	財務成本	(29,394)	(1)	(24,400)	-
7070	採用權益法認列子公司利益之份額(附註六(五))	602,436	13	419,887	10
		627,182	13	501,475	12
	稅前淨利	522,430	11	532,203	13
7950	減：所得稅費用(附註六(十三))	12,854	-	68,352	2
	本期淨利	509,576	11	463,851	11
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註六(十二))	2,015	-	1,328	-
8330	採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	(908)	-	(3,999)	-
		1,107	-	(2,671)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(30,956)	(1)	174,852	4
		(30,956)	(1)	174,852	4
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(29,849)	(1)	172,181	4
	本期綜合損益總額	\$ 479,727	10	636,032	15
	基本每股盈餘(元)(附註六(十九))	\$ 2.07		1.87	
	稀釋每股盈餘(元)(附註六(十九))	\$ 2.07		1.87	

董事長：王秀亭



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司

權益變動表

民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股 本	資本公積	保留盈餘			合 計	其他權益項目	庫藏股票	權益總額
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘		國外營運 機構財務報表 換算之兌換 差 額		
民國一一三年一月一日餘額	\$ 2,634,854	2,209,251	1,129,743	531,125	2,155,995	3,816,863	(419,530)	(506,043)	7,735,395
本期淨利	-	-	-	-	463,851	463,851	-	-	463,851
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,671)	(2,671)	174,852	-	172,181
本期綜合損益總額	-	-	-	-	461,180	461,180	174,852	-	636,032
子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(93,835)	(93,835)
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	71,521	-	(71,521)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(526,971)	(526,971)	-	-	(526,971)
發放予子公司股利調整資本公積	-	31,920	-	-	-	-	-	-	31,920
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	11,813	-	-	-	-	-	-	11,813
民國一一三年十二月三十一日餘額	2,634,854	2,252,984	1,201,264	531,125	2,018,683	3,751,072	(244,678)	(599,878)	7,794,354
本期淨利	-	-	-	-	509,576	509,576	-	-	509,576
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,107	1,107	(30,956)	-	(29,849)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	510,683	510,683	(30,956)	-	479,727
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(141,417)	(141,417)
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	46,118	-	(46,118)	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(228,976)	228,976	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(526,971)	(526,971)	-	-	(526,971)
發放予子公司股利調整資本公積	-	32,288	-	-	-	-	-	-	32,288
股份基礎給付交易酬勞成本	-	7,155	-	-	-	-	-	-	7,155
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	(2,297)	-	-	-	-	-	-	(2,297)
民國一一四年十二月三十一日餘額	\$ 2,634,854	2,290,130	1,247,382	302,149	2,185,253	3,734,784	(275,634)	(741,295)	7,642,839

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司

現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 522,430	532,203
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	399,318	371,455
攤銷費用	15,297	35,853
預期信用減損損失	771	151
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(38,198)	(9,430)
利息費用	27,991	23,247
利息收入	(5,154)	(5,476)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(602,436)	(419,887)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(3,524)	(746)
其他	(15,853)	354
收益費損項目合計	(221,788)	(4,479)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(40,691)	1,636
應收票據減少	12	270
應收帳款增加	(74,170)	(55,164)
應收帳款－關係人(增加)減少	2,466	(84,143)
其他應收款(增加)減少	(4,984)	1,064
存貨減少	174,529	140,556
其他流動資產增加	(8,084)	(41,699)
應付帳款增加(減少)	32,158	(12,247)
應付帳款－關係人增加	390,865	19,857
其他應付款增加	180	605
其他應付款－關係人增加(減少)	(23,671)	8,367
其他流動負債增加(減少)	(28,256)	5,545
淨確定福利負債減少	(283)	(15,563)
調整項目合計	198,283	(35,395)
營運產生之現金流入	720,713	496,808
收取之利息	5,172	5,478
收取之股利	267,277	560,165
支付之利息	(29,273)	(25,614)
支付之所得稅	(33,171)	(117,273)
營業活動之淨現金流入	930,718	919,564
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(38,104)	(34,145)
取得不動產、廠房及設備	(83,429)	(115,047)
處分不動產、廠房及設備	1,680	1,101
取得無形資產	(789)	(9,092)
其他非流動資產減少	26,121	66,361
預付設備款增加	(94,922)	(252,819)
投資活動之淨現金流出	(189,443)	(343,641)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(36,475)	(504,935)
舉借長期借款	191,400	522,550
償還長期借款	(120,342)	(298,583)
租賃本金償還	(971)	(971)
發放現金股利	(526,971)	(526,971)
庫藏股買回成本	(141,417)	-
籌資活動之淨現金流出	(634,776)	(808,910)
本期現金及約當現金增加(減少)數	106,499	(232,987)
期初現金及約當現金餘額	562,610	795,597
期末現金及約當現金餘額	\$ 669,109	562,610

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠



聲 明 書

本公司民國一一四年度(自一一四年一月一日至一一四年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第10號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：台灣半導體股份有限公司

董 事 長：王秀亭



日 期：民國一一五年三月十三日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No.7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

台灣半導體股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

台灣半導體股份有限公司及其子公司(台半集團)民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台半集團民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台灣半導體股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

其他事項

列入台半集團合併財務報告之子公司中，於民國一一四年十二月三十一日有關鼎翰科技股份有限公司(鼎翰科技)之部分子公司財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關鼎翰科技該等子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一一四年十二月三十一日之資產總額占合併資產總額之10.70%，民國一一四年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額占合併營業收入淨額之20.81%。

列入台半集團合併財務報告之子公司中，於民國一一三年十二月三十一日有關鼎翰科技之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關鼎翰科技財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。鼎翰科技民國一一三年十二月三十一日之資產總額占合併資產總額之55.02%，民國一一三年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額占合併營業收入淨額之59.33%。

台灣半導體股份有限公司已編製民國一一四年及一一三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，備供參考。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台半集團民國一一四年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入認列；收入之說明，請詳合併財務報告附註六(十八)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

台灣半導體股份有限公司及其子公司主要營業項目為整流器之製造及買賣業務及自動辨識系統產品製造與服務，收入認列為本會計師執行該公司財務報告查核重要的評估事項之一。銷貨收入係投資人及管理階層評估公司績效之主要指標，故收入認列之合理性為本會計師執行查核重要評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序，包括測試銷貨及收款作業循環之相關控制，以確定收入紀錄可靠性；針對銷售系統資料與總帳分錄進行核對及調節，及評估銷售條件與會計政策認列之一致性；針對前十大銷售客戶進行趨勢分析，以評估是否有重大異常；選定資產負債表日前後一段期間之出貨，核對相關憑證及表單以確定銷貨收入是否認列於財務報表適當期間。

二、商譽之減損評估

有關商譽減損之會計政策請詳合併財務報告附註四(十二)非金融資產減損；商譽之減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(三)商譽之減損評估；合併財務報告商譽減損之說明，請詳合併財務報告附註六(九)商譽。

關鍵查核事項之說明：

台半集團條碼列印機部門於取得業務及控制權時，於合併財務報告認列商譽，該等金額對合併財務報告係屬重大。此外，衡量商譽是否減損，有賴對現金產生單位未來現金流量之估計以決定可回收金額，未來現金流量之估計涉及產業狀況及未來營運成果等之預估，該等預估情況一旦改變，將影響可回收金額而產生減損。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括取得鼎翰科技管理階層委任之評價專家所出具之商譽價值減損測試評估報告及管理階層自行評估之商譽減損測試評估，瞭解並評估其評價模型所計算可回收金額之合理性；並對評價模型所使用之假設包括銷售成長率、利潤率、加權平均資金成本（包括無風險報酬利率及風險貼水報酬）等，考量公司營運狀況、所屬產業情況及未來展望等，綜合評估上述商譽減損評估報告之合理性。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估台半集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台半集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台半集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台半集團內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台半集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台半集團不再具有繼續經營之能力。

5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台半集團民國一一四年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

郭仰倫



蕭佩如



證券主管機關：金管證審字第1120333238號
核准簽證文號：金管證審字第1040003949號
民國一一五年三月十三日

台灣半導體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一四年及一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產		114.12.31		113.12.31		負債及權益		114.12.31		113.12.31	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 3,535,194	16	3,524,621	16	2100	短期借款(附註六(十))	\$ 1,540,103	7	2,286,701	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	60,444	-	20,132	-	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	67,595	-	70,121	-
1150	應收票據淨額(附註六(三)及(十八))	69	-	12	-	2170	應付帳款	1,656,680	8	1,374,344	6
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及(十八))	3,314,903	16	3,365,399	16	2200	其他應付款(附註六(十二))	892,386	4	939,090	4
1200	其他應收款	113,308	1	92,526	-	2230	本期所得稅負債	159,000	1	262,800	1
1220	本期所得稅資產	4,903	-	92,323	-	2280	租賃負債－流動(附註六(十三))	148,063	1	134,573	1
130X	存貨(附註六(四))	3,815,967	18	3,878,007	18	2322	一年內到期長期借款(附註六(十一))	396,973	2	314,125	1
1410	預付款項	348,898	1	336,591	2	2399	其他流動負債	351,281	1	366,583	2
1470	其他流動資產	9,708	-	21,671	-			5,212,081	24	5,748,337	26
1476	其他金融資產－流動(附註六(二))	539,520	3	401,899	2						
		11,742,914	55	11,733,181	54						
非流動資產：						非流動負債：					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	125,237	1	66,152	-	2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動(附註六(二))	-	-	26,784	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六))	4,270,061	20	4,414,437	21	2540	長期借款(附註六(十一))	3,123,138	15	2,980,445	14
1755	使用權資產(附註六(七))	686,313	3	701,081	4	2570	遞延所得稅負債(附註六(十五))	1,224,622	6	1,188,571	6
1805	商譽(附註六(九))	1,988,321	9	2,029,444	10	2580	租賃負債－非流動(附註六(十三))	562,059	2	568,029	3
1822	無形資產(附註六(八))	1,017,928	5	1,148,483	5	2640	淨確定福利負債－非流動(附註六(十四))	20,917	-	21,033	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	822,051	4	729,049	3	2670	其他非流動負債	70,134	-	62,216	-
1980	其他金融資產－非流動(附註六(二))	133,764	1	281,206	1			5,000,870	23	4,847,078	23
1990	其他非流動資產(附註六(十四))	408,686	2	437,009	2			10,212,951	47	10,595,415	49
		9,452,361	45	9,806,861	46						
資產總計		\$ 21,195,275	100	21,540,042	100	負債總計					
						歸屬母公司業主之權益：					
						3110	普通股股本	2,634,854	12	2,634,854	12
						3200	資本公積	2,290,130	11	2,252,984	11
						3300	保留盈餘	3,734,784	18	3,751,072	17
						3400	其他權益	(275,634)	(1)	(244,678)	(1)
						3500	庫藏股票	(741,295)	(3)	(599,878)	(3)
							歸屬母公司業主之權益合計	7,642,839	37	7,794,354	36
						36XX	非控制權益(附註六(五))	3,339,485	16	3,150,273	15
							權益總計	10,982,324	53	10,944,627	51
							負債及權益總計	\$ 21,195,275	100	21,540,042	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王秀亭

經理人：王秀亭

會計主管：鄭懿誠

台灣半導體股份有限公司及其子公司
合併綜合損益表
民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

		114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
4110	銷貨收入(附註六(十八))	\$ 18,585,489	104	15,353,489	104
4190	減：銷貨退回及折讓	631,230	4	524,697	4
	營業收入淨額	17,954,259	100	14,828,792	100
5000	營業成本(附註六(四))	12,664,153	71	10,594,202	71
	營業毛利	5,290,106	29	4,234,590	29
6000	營業費用(附註六(十四)及(二十))：				
6100	推銷費用	2,029,921	11	1,605,261	11
6200	管理費用	957,262	5	884,260	6
6300	研究發展費用	815,020	4	496,684	3
6450	預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(三))	19,767	-	(8,830)	-
		3,821,970	20	2,977,375	20
	營業淨利	1,468,136	9	1,257,215	9
	營業外收入及支出(附註六(十九))：				
7100	利息收入	45,800	-	41,582	-
7010	其他收入	37,701	-	47,322	-
7020	其他利益及損失	57,204	-	100,760	1
7050	財務成本	(175,702)	(1)	(118,520)	(1)
		(34,997)	(1)	71,144	-
	稅前淨利	1,433,139	8	1,328,359	9
7950	減：所得稅費用(附註六(十五))	320,577	2	433,446	3
	本期淨利	1,112,562	6	894,913	6
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註六(十四))	(528)	-	(10,275)	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
		(528)	-	(10,275)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(106,099)	(1)	232,964	2
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五))	19,418	-	(17,219)	-
		(86,681)	(1)	215,745	2
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(87,209)	(1)	205,470	2
	本期綜合損益總額	\$ 1,025,353	5	1,100,383	8
	本期淨利歸屬於：				
	母公司業主	\$ 509,576	3	463,851	3
	非控制權益(附註六(五))	602,986	3	431,062	3
		\$ 1,112,562	6	894,913	6
	綜合損益總額歸屬於：				
	母公司業主	\$ 479,727	2	636,032	5
	非控制權益(附註六(五))	545,626	3	464,351	3
		\$ 1,025,353	5	1,100,383	8
	基本每股盈餘(元)(附註六(二十一))	\$ 2.07		1.87	
	稀釋每股盈餘(元)(附註六(二十一))	\$ 2.07		1.87	

董事長：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	普通股 股 本	資本公積	保留盈餘			合 計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	庫藏股票	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權 益	權益總額
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘						
民國一一三年一月一日餘額	\$ 2,634,854	2,209,251	1,129,743	531,125	2,155,995	3,816,863	(419,530)	(506,043)	7,735,395	2,964,073	10,699,468
本期淨利	-	-	-	-	463,851	463,851	-	-	463,851	431,062	894,913
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,671)	(2,671)	174,852	-	172,181	33,289	205,470
本期綜合損益總額	-	-	-	-	461,180	461,180	174,852	-	636,032	464,351	1,100,383
子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(93,835)	(93,835)	-	(93,835)
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	71,521	-	(71,521)	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(526,971)	(526,971)	-	-	(526,971)	-	(526,971)
發放予子公司股利調整資本公積	-	31,920	-	-	-	-	-	-	31,920	-	31,920
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	11,813	-	-	-	-	-	-	11,813	-	11,813
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(278,151)	(278,151)
民國一一三年十二月三十一日餘額	2,634,854	2,252,984	1,201,264	531,125	2,018,683	3,751,072	(244,678)	(599,878)	7,794,354	3,150,273	10,944,627
本期淨利	-	-	-	-	509,576	509,576	-	-	509,576	602,986	1,112,562
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,107	1,107	(30,956)	-	(29,849)	(57,360)	(87,209)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	510,683	510,683	(30,956)	-	479,727	545,626	1,025,353
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(141,417)	(141,417)	-	(141,417)
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	46,118	-	(46,118)	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(228,976)	228,976	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(526,971)	(526,971)	-	-	(526,971)	-	(526,971)
發放予子公司股利調整資本公積	-	32,288	-	-	-	-	-	-	32,288	-	32,288
股份基礎給付交易酬勞成本	-	7,155	-	-	-	-	-	-	7,155	-	7,155
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	(2,297)	-	-	-	-	-	-	(2,297)	-	(2,297)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(356,414)	(356,414)
民國一一四年十二月三十一日餘額	\$ 2,634,854	2,290,130	1,247,382	302,149	2,185,253	3,734,784	(275,634)	(741,295)	7,642,839	3,339,485	10,982,324

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王秀亭

經理人：王秀亭

會計主管：鄭懿誠

台灣半導體股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,433,139	1,328,359
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	901,568	901,862
攤銷費用	216,365	125,077
預期信用減損損失(迴轉利益)	19,767	(8,830)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(33,724)	18,315
利息費用	133,361	116,975
利息收入	(45,800)	(41,582)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	22,162	6,444
處分無形資產損失	-	20
非金融資產減損迴轉利益	(522)	(1,648)
其他	4,858	11,813
收益費損項目合計	1,218,035	1,128,446
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產／負債增減	(66,160)	242
應收票據(增加)減少	(57)	295
應收帳款(增加)減少	30,729	(336,107)
其他應收款(增加)減少	(11,519)	11,045
存貨減少	62,040	216,415
預付款項增加	(12,307)	(144,537)
其他流動資產減少	11,963	10,654
其他金融資產減少	133,980	78,990
應付帳款增加(減少)	282,336	(107,916)
其他應付款減少	(46,884)	(56,445)
其他流動負債減少	(20,299)	(27,372)
淨確定福利負債減少	(116)	(22,756)
其他非流動負債增加	9,637	8,898
調整項目合計	1,591,378	759,852
營運產生之現金流入	3,024,517	2,088,211
收取之利息	45,818	41,584
支付之利息	(98,504)	(87,332)
支付之所得稅	(393,908)	(417,197)
營業活動之淨現金流入	2,577,923	1,625,266
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(38,104)	(34,145)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	(2,370,265)
取得不動產、廠房及設備	(290,404)	(220,085)
處分不動產、廠房及設備	9,343	3,030
取得無形資產	(83,883)	(33,425)
其他金融資產增加	(124,159)	(234,210)
其他非流動資產(增加)減少	15,676	(21,606)
預付設備款增加	(291,731)	(235,217)
投資活動之淨現金流出	(803,262)	(3,145,923)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(746,598)	665,306
舉借長期借款	1,453,023	2,754,753
償還長期借款	(1,228,448)	(607,482)
租賃本金償還	(150,557)	(96,646)
存入保證金減少	(638)	(1)
發放現金股利	(494,683)	(495,051)
庫藏股票買回成本	(141,417)	(93,835)
非控制權益淨變動	(356,414)	(278,151)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(1,665,732)	1,848,893
匯率變動對現金及約當現金之影響	(98,356)	(187,062)
本期現金及約當現金增加(減少)數	10,573	141,174
期初現金及約當現金餘額	3,524,621	3,383,447
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,535,194	3,524,621

董事長：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠



(附件二)

台灣半導體股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造具民國 114 年度營業報告書、個體財務報告、合併財務報告及盈餘分配議案，其中個體財務報告及合併財務報告業經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所郭仰倫會計師及蕭佩如會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、個體財務報告、合併財務報告及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定繕具報告。

敬請 鑒核

此 致

台灣半導體股份有限公司 115 年股東常會

台灣半導體股份有限公司

審計委員會召集人：詹乾隆



審 計 委 員：馬述壯



審 計 委 員：陳淑玲



審 計 委 員：王念秋



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 十 三 日

(附件四)

台灣半導體股份有限公司
114 年度
盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金額小計	金額合計
期初未分配盈餘	1,674,569,359	
加：114 年度稅後純益	509,576,774	
加：確定福利計劃之再衡量數	1,106,866	
減：提列 10%法定盈餘公積	51,068,364	
本期可供分配盈餘		<u>2,134,184,635</u>
減：分配項目		
(1)股東股利 (每股 NT\$ 2.0 元)		
(現金股利每股 2.0 元)----(註)	<u>526,970,972</u>	<u>526,970,972</u>
期末未分配盈餘		<u>1,607,213,663</u>

註：

- 嗣後如因本公司流通在外股數有增減變動，致股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 本期股東股利共計發放金額為 NT\$ 526,970,972 元。
- 114 年度稅後純益經分配後剩餘 NT\$ 0 元未分配。

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠

